

Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen

2018	Verkündet am 24. Januar 2018	Nr. 8
------	------------------------------	-------

Ordnung zur Änderung der Masterprüfungsordnung der Hochschule Bremen für den konsekutiven Studiengang Electronics Engineering (Fachspezifischer Teil)

Vom 14. November 2017

Die Rektorin der Hochschule Bremen hat am 10. Januar 2018 gemäß § 110 Absatz 3 des Bremischen Hochschulgesetzes (BremHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. August 2017 (Brem.GBl. S. 263), die nachfolgende Ordnung zur Änderung der Masterprüfungsordnung der Hochschule Bremen für den konsekutiven Studiengang Electronics Engineering (Fachspezifischer Teil) genehmigt.

Artikel 1

Die Masterprüfungsordnung der Hochschule Bremen für den konsekutiven Studiengang Electronics Engineering (Fachspezifischer Teil) vom 27. März 2012 (Brem.ABl. S. 513), die zuletzt durch Ordnung vom 4. Juni 2013 (Brem.ABl. S. 680) geändert wurde, wird wie folgt geändert:

Anlage 1 erhält die nachfolgende Fassung.

Artikel 2

Diese Änderungsordnung tritt am 1. März 2018 in Kraft.

Bremen, den 10. Januar 2018

Die Rektorin der Hochschule Bremen

Anlage 1: Prüfungsleistungen der Masterprüfung**a) Studienprofil Microsystems Engineering**

Module	SWS¹	Cre- dits²	Prüfungsleistung³
1. Semester			
1.1 Material Science		6	KL oder MP (60 %) EA (40 %)
1.1.1 Material Science	2		
1.1.2 Material Science	2		
1.2 Concept Engineering for Mixed-Technology Systems		6	KL oder MP (60 %) EA (40 %)
1.2.1 Concept Engineering for Mixed-Technology Systems	2		
1.2.2 Concept Engineering for Mixed-Technology Systems	2		
1.3 Wahlpflichtmodul Katalog technische Module		6	KL oder MP (60 %) EA (40 %)
1.3.1 Wahlpflichtmodul	2		
1.3.2 Wahlpflichtmodul	2		
1.4 Wahlpflichtmodul Katalog technische Module		6	KL oder MP (60 %) EA (40 %)
1.4.1 Wahlpflichtmodul	2		
1.4.2 Wahlpflichtmodul	2		
1.5 Wahlpflichtmodul Katalog nichttechnische Module		6	MP (60 %) EA (40 %)
1.5.1 Wahlpflichtmodul	2		
1.5.2 Wahlpflichtmodul	2		
2. Semester			
2.1 Advanced Hardware Verification		6	KL oder MP (60 %) EA (40 %)
2.1.1 Advanced Hardware Verification	2		
2.1.2 Advanced Hardware Verification	2		
2.2 Micro-Technology and Micro-Systems		6	KL oder MP (60 %) EA (40 %)
2.2.1 Micro-Technology and Micro-Systems	2		
2.2.2 Micro-Technology and Micro-Systems	2		
2.3 Wahlpflichtmodul Katalog technische Module		6	KL oder MP (60 %) EA (40 %)
2.3.1 Wahlpflichtmodul	2		
2.3.2 Wahlpflichtmodul	2		

¹ Zahl der Semesterwochenstunden Präsenzstudium

² Leistungspunkte nach ECTS

³ Form der Prüfungsleistung: KL = Klausur, MP = mündliche Prüfung, Kolloquium, EA = Entwicklungsarbeit

Module	SWS ¹	Cre-dits ²	Prüfungsleistung ³
2.4 Wahlpflichtmodul Katalog technische Module		6	KL oder MP (60 %) EA (40 %)
2.4.1 Wahlpflichtmodul	2		
2.4.2 Wahlpflichtmodul	2		
2.5 Wahlpflichtmodul Katalog nichttechnische Module		6	MP (50 %) EA (50 %)
2.5.1 Wahlpflichtmodul	2		
2.5.2 Wahlpflichtmodul	2		
3. Semester			
Modul 3.1 Masterthesis		30	Thesis + Kolloquium
3.1.1 Masterthesis	4		
Summe	44	90	

b) Studienprofil Measurement and Instrumentation

	SWS ¹	Cre-dits ²	Prüfungsleistung ³
1. Semester			
1.1 Measurement and Instrumentation		6	KL oder MP (60 %) EA (40 %)
1.1.1 Measurement and Instrumentation	2		
1.1.2 Measurement and Instrumentation	2		
1.2 Laser Systems and Applications		6	KL oder MP (60 %) EA (40 %)
1.2.1 Laser Systems and Applications	2		
1.2.2 Laser Systems and Applications	2		
1.3 Wahlpflichtmodul Katalog technische Module		6	KL oder MP (60 %) EA (40 %)
1.3.1 Wahlpflichtmodul	2		
1.3.2 Wahlpflichtmodul	2		
1.4 Wahlpflichtmodul Katalog technische Module		6	KL oder MP (60 %) EA (40 %)
1.4.1 Wahlpflichtmodul	2		
1.4.2 Wahlpflichtmodul	2		
1.5 Wahlpflichtmodul Katalog nichttechnische Module		6	MP (60 %) EA (40 %)
1.5.1 Wahlpflichtmodul	2		
1.5.2 Wahlpflichtmodul	2		
2. Semester			
2.1 Computer Aided Data Aquisition		6	KL oder MP (60 %)

¹ Zahl der Semesterwochenstunden Präsenzstudium

² Leistungspunkte nach ECTS.

³ Form der Prüfungsleistung: KL = Klausur, MP = mündliche Prüfung, Kolloquium, EA = Entwicklungsarbeit

	SWS ¹	Cre-dits ²	Prüfungsleistung ³
			EA (40 %)
2.1.1 Computer Aided Data Aquisition	2		
2.1.2 Computer Aided Data Aquisition	2		
2.2 Fiber Optic Test and Measurement		6	KL oder MP (60 %) EA (40 %)
2.2.1 Fiber Optic Test and Measurement	2		
2.2.2 Fiber Optic Test and Measurement	2		
2.3 Wahlpflichtmodul Katalog technische Module		6	KL oder MP (60 %) EA (40 %)
2.3.1 Wahlpflichtmodul	2		
2.3.2 Wahlpflichtmodul	2		
2.4 Wahlpflichtmodul Katalog technische Module		6	KL oder MP (60 %) EA (40 %)
2.4.1 Wahlpflichtmodul	2		
2.4.2 Wahlpflichtmodul	2		
2.5 Wahlpflichtmodul Katalog nichttechnische Module		6	MP (50 %) EA (50 %)
2.5.1 Wahlpflichtmodul	2		
2.5.2 Wahlpflichtmodul	2		
3. Semester			
3.1 Masterthesis		30	Thesis + Kolloquium
3.1.1 Masterthesis	4		
Summe	44	90	

c) Studienprofil Communication Systems Engineering

	SWS ¹	Cre-dits ²	Prüfungsleistung ³
1. Semester			
1.1 Stochastic Signals and Systems		6	KL oder MP (60 %) EA (40 %)
1.1.1 Stochastic Signals and Systems	2		
1.1.2 Stochastic Signals and Systems	2		
1.2 Advanced Digital Signal Processing		6	KL oder MP (60 %) EA (40 %)
1.2.1 Advanced Digital Signal Processing	2		
1.2.2 Advanced Digital Signal Processing	2		
1.3 Wahlpflichtmodul Katalog technische Module		6	KL oder MP (60 %) EA (40 %)
1.3.1 Wahlpflichtmodul	2		

¹ Zahl der Semesterwochenstunden Präsenzstudium

² Leistungspunkte nach ECTS

³ Form der Prüfungsleistung: KL = Klausur, MP = mündliche Prüfung, Kolloquium, EA = Entwicklungsarbeit

	SWS ¹	Cre- dits ²	Prüfungsleistung ³
1.3.2 Wahlpflichtmodul	2		
1.4 Wahlpflichtmodul Katalog technische Module		6	KL oder MP (60 %) EA (40 %)
1.4.1 Wahlpflichtmodul	2		
1.4.2 Wahlpflichtmodul	2		
1.5 Wahlpflichtmodul Katalog nichttechnische Module		6	MP (60 %) EA (40 %)
1.5.1 Wahlpflichtmodul	2		
1.5.2 Wahlpflichtmodul	2		
2. Semester			
2.1 Source and Channel Coding		6	KL oder MP (60 %) EA (40 %)
2.1.1 Source and Channel Coding	2		
2.1.2 Source and Channel Coding	2		
2.2 Microwave Circuits and Systems		6	KL oder MP (60 %) EA (40 %)
2.2.1 Microwave Circuits and Systems	2		
2.2.2 Microwave Circuits and Systems	2		
2.3 Wahlpflichtmodul Katalog technische Module		6	KL oder MP (60 %) EA (40 %)
2.3.1 Wahlpflichtmodul	2		
2.3.2 Wahlpflichtmodul	2		
2.4 Wahlpflichtmodul Katalog technische Module		6	KL oder MP (60 %) EA (40 %)
2.4.1 Wahlpflichtmodul	2		
2.4.2 Wahlpflichtmodul	2		
2.5 Wahlpflichtmodul Katalog nichttechnische Module		6	MP (50 %) EA (50 %)
2.5.1 Wahlpflichtmodul	2		
2.5.2 Wahlpflichtmodul	2		
3. Semester			
Modul 3.1 Masterthesis		30	Thesis + Kolloquium
3.1.1 Masterthesis	4		
Summe	44	90	

¹ Zahl der Semesterwochenstunden Präsenzstudium

² Leistungspunkte nach ECTS.

³ Form der Prüfungsleistung: KL = Klausur, MP = mündliche Prüfung, Kolloquium, EA = Entwicklungsarbeit.

d) Wahlpflichtmodule

Katalog der technischen Module im Wintersemester

	SWS ¹	Cre- dits ²	Prüfungsleistung ³
1.6 Communication Networks		6	KL oder MP (60 %) EA (40 %)
1.6.1 Communication Networks	2		
1.6.2 Communication Networks	2		
1.7 Optical Communications		6	KL oder MP (60 %) EA (40 %)
1.7.1 Optical Communications	2		
1.7.2 Optical Communications	2		
1.8 Satellite Communications		6	KL oder MP (60 %) EA (40 %)
1.8.1 Satellite Communications	2		
1.8.2 Satellite Communications	2		
1.9 Image Processing and Pattern Recognition		6	KL oder MP (60 %) EA (40 %)
1.9.1 Image Processing and Pattern Recognition	2		
1.9.2 Image Processing and Pattern Recognition	2		
1.10 Electronics Engineering Project I		6	KL oder MP (60 %) EA (40 %)
1.10.1 Electronics Engineering Project I	2		
1.10.2 Electronics Engineering Project I	2		

¹ Zahl der Semesterwochenstunden Präsenzstudium S = Seminar, L = Labor, P = Projekt

² Leistungspunkte nach ECTS.

³ Form der Prüfungsleistung: KL = Klausur, MP = mündliche Prüfung, Kolloquium, EA = Entwicklungsarbeit

Katalog der technischen Module im Sommersemester

	SWS¹	Cre- dits²	Prüfungsleistung³
2.6 Advanced Topics of Lasers		6	KL oder MP (60 %) EA (40 %)
2.6.1 Advanced Topics of Lasers	2		
2.6.2 Advanced Topics of Lasers	2		
2.7 Underwater Acoustics and Sonar Signal Processing		6	KL oder MP (60 %) EA (40 %)
2.7.1 Underwater Acoustics and Sonar Signal Processing	2		
2.7.2 Underwater Acoustics and Sonar Signal Processing	2		
2.8 Wireless Communications		6	KL oder MP (60 %) EA (40 %)
2.8.1 Wireless Communications	2		
2.8.2 Wireless Communications	2		
2.9 Analogue and Mixed Signal Circuit Design		6	KL oder MP (60 %) EA (40 %)
2.9.1 Analogue and Mixed Signal Circuit Design	2		
2.9.2 Analogue and Mixed Signal Circuit Design	2		
2.10 Electronics Engineering Project II		6	KL oder MP (60 %) EA (40 %)
2.10.1 Electronics Engineering Project II	2		
2.10.2 Electronics Engineering Project II	2		

¹ Zahl der Semesterwochenstunden Präsenzstudium S = Seminar, L = Labor, P = Projekt

² Leistungspunkte nach ECTS

³ Form der Prüfungsleistung: KL = Klausur, MP = mündliche Prüfung, Kolloquium, EA = Entwicklungsarbeit

Katalog der nichttechnischen Module

	SWS¹	Cre- dits²	Prüfungsleistung³
1.11 / 2.11 Organisational Behaviour		6	MP (50 %) EA (50 %)
1.11.1 Organisational Behaviour I / WS	1		
1.11.2 Organisational Behaviour I / WS	1		
2.11.1 Organisational Behaviour II / SS	1		
2.11.2 Organisational Behaviour II / SS	1		
1.12 / 2.12 Projectmanagement and Teambuilding		6	MP (50 %) EA (50 %)
1.12.1 Projectmanagement and Teambuilding I / WS	1		
1.12.2 Projectmanagement and Teambuilding I / WS	1		
2.12.1 Projectmanagement and Teambuilding II / SS	1		
2.12.2 Projectmanagement and Teambuilding II / SS	1		
1.13 / 2.13 Operations Management		6	MP (50 %) EA (50 %)
1.13.1 Operations Management I / WS	1		
1.13.2 Operations Management I / WS	1		
2.13.1 Operations Management II / SS	1		
2.13.2 Operations Management II / SS	1		
1.14 / 2.14 Sprachmodul Deutsch		6	MP (50 %) EA (50 %)
1.14.1 Sprachmodul Deutsch I / WS	1		
1.14.2 Sprachmodul Deutsch I / WS	1		
2.14.1 Sprachmodul Deutsch II / SS	1		
2.14.2 Sprachmodul Deutsch II / SS	1		

¹ Zahl der Semesterwochenstunden Präsenzstudium S = Seminar, L = Labor, P = Projekt

² Leistungspunkte nach ECTS

³ Form der Prüfungsleistung: KL = Klausur, MP = mündliche Prüfung, Kolloquium, EA = Entwicklungsarbeit